

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



香港聯交所股票代號： 1347

新聞稿

華虹半導體二零一八年第四季度業績公佈

所有貨幣以美元列帳，除非特別指明。

本合併財務報告系依香港財務報告準則編製。

中國香港 — 2019年1月31日 — 全球領先的特色工藝純晶圓代工廠華虹半導體有限公司（香港聯交所股票代號：1347）（「本公司」）於今日公佈截至二零一八年十二月三十一日止三個月的綜合經營業績。

二零一八年第四季度主要財務指標（未經審核）

- 銷售收入再創新高，達 2.491 億美元，同比增長 14.8%，環比增長 3.3%。
- 毛利率 34.0%，同比上升 0.3 個百分點，環比持平。
- 期內溢利 4,860 萬美元，同比上升 17.0%，環比下降 4.6%。
- 基本每股盈利 0.042 美元，同比上升 0.002 美元，環比下降 0.004 美元。
- 淨資產收益率（年化）9.6%。

二零一八年度（未經審核）

- 銷售收入創歷史新高，達 9.303 億美元，較上年度大幅增長 15.1%。
- 毛利率 33.4%，較上年度提升 0.3 個百分點。
- 年內溢利 1.856 億美元，較上年度增加 27.8%。
- 基本每股盈利 0.171 美元，較上年度上升 0.031 美元。
- 淨資產收益率 10.2%，較上年度提高 1.1 個百分點。

二零一九年第一季度指引

- 我們預計銷售收入約 2.20 億美元左右。同比預計將增長約 4.7% 左右。
- 我們預計毛利率約 32% 左右。

二零一八年度股利派發

- 公司將會在二零一九年五月召開的周年大會上，決定二零一八會計年度股利分配方案。

總裁致辭

本公司總裁兼執行董事王煜先生，對第四季度和二零一八年全年的業績評論道：

“我們對華虹半導體第四季度的業績表現極其滿意。儘管市場普遍疲軟，但我們的勢頭持續強勁。銷售收入再創新高，達 2.491 億美元，同比增長 14.8%，環比增長 3.3%，主要得益於銀行卡芯片、MCU、超級結和通用 MOSFET 產品的需求增加。在工廠持續高產能利用率、部分產品的銷售價格提升、以及不斷優化的產品組合的影響下，毛利率持續維持在相當可觀的 34%。”

“我們對 2018 年充滿成就感，”王煜先生繼續對公司年度業績評論道，“銷售收入總額達 9.303 億美元，較 2017 年增長 15.1%，這得益於我們提供的特色工藝平臺，尤其在嵌入式非易失性存儲器和分立器件技術平臺方面。毛利率繼續保持強勁，增長至 33.4%，得益於持續的高產能利用率及平均售價的提升。淨利潤率上升至 20%，較上年度上升兩個百分點。淨資產收益率上升至 10.2%，提升了 1.1 個百分點。我們之所以取得如此巨大的成功，完全歸功於股東和董事的全力支持，以及全體員工的兢兢業業、勇於創新和奉獻精神。”

王煜總裁隨後簡要介紹了 300mm 項目的進展情況。“無錫工廠項目正按照計劃平穩推進。我們預計將在第二季度末完成廠房和潔淨室的建設，在下半年開始搬入設備，並在二零一九年第四季度開始 300mm 晶圓的量產。研發活動早在幾個月前就已經開始，我們的技術開發和市場營銷人員已經為客戶、技術和產品制定了初步量產計劃。隨着無錫工廠的投產，我們產能受限的情況必將得到極大的緩解，並使我們能提供更好的解決方案以滿足客戶的整體需求。這將使公司更上層樓。”

王煜總裁總結道，“我熱愛我們的團隊，他們始終表現出了不懈的原動力和無私的奉獻精神，儘管過往成績輝煌，仍然精益求精、追求卓越。同時，我也對我們已被多次得到驗證的特色工藝戰略充滿信心。這兩個元素相輔相成，必將帶領我們走得更長遠。”

電話會議公告

日期： 二零一九年二月一日（星期五）

時間： 下午 04:00（上海 / 香港）
上午 03:00（紐約，2019 年 2 月 1 日，星期五）

發言人： 王煜，總裁兼執行董事
王鼎，執行副總裁兼首席財務官

廣播： 該電話會議將於下述網站進行語音及幻燈片直播：

http://www.huahonggrace.com/html/investor_webcast.php 或

https://engage.vevent.com/rt/huahongsemiconductor~4q_2018_earnings_call

電話詳細：

国际	+65 6713 5521
中國	+86 800 870 0531/+86 400 624 0406
香港	+852 3018 6768
臺灣	+886 277 031 751
紐約	+1 347 549 4095

電話會議登入名： 5469818

密碼： HUAHONG

直播約 24 小時後，您可於 12 個月內在 http://www.huahonggrace.com/s/investor_webcast.php 網頁上，重複收聽會議。（回放密碼：Huahong）

關於華虹半導體

華虹半導體有限公司（「華虹半導體」，股份代號：1347.HK）（“本公司”）是全球領先的純晶圓代工企業，特別專注於嵌入式非易失性存儲器、功率器件、模擬與電源管理和邏輯及射頻等差異化特色工藝平臺，其卓越的質量管理體系亦滿足汽車電子芯片生產的嚴苛要求。本公司是華虹集團的一員，而華虹集團是國家“909”工程的載體，是以集成電路製造為主業、面向全球市場、具有自主創新能力和市場競爭力的高科技產業集團。

本公司在上海金橋和張江建有三座 200mm 晶圓廠（華虹一廠、二廠、及三廠），月產能約 17.4 萬片；同時在無錫高新技術產業開發區內新建一條月產能 4 萬片的 300mm 集成電路生產線（華虹七廠）。

如需查詢詳細資訊，請登陸華虹半導體網站 <http://www.huahonggrace.com/>。

經營業績概要
(以千美元計，每股盈利和營運數據除外)

	二零一八年 第四季度 (未經審核)	二零一七年 第四季度 (未經審核)	二零一八年 第三季度 (未經審核)	同比	環比
銷售收入	249,086	216,916	241,222	14.8 %	3.3 %
銷售成本	(164,508)	(143,809)	(159,276)	14.4 %	3.3 %
毛利	84,578	73,107	81,946	15.7 %	3.2 %
毛利率	34.0 %	33.7 %	34.0 %	0.3	-
經營開支	(38,819)	(36,773)	(31,798)	5.6 %	22.1 %
其他收入淨額	11,620	12,200	14,320	(4.8)%	(18.9)%
稅前溢利	57,379	48,534	64,468	18.2 %	(11.0)%
所得稅開支	(8,818)	(7,032)	(13,547)	25.4 %	(34.9)%
期內溢利	48,561	41,502	50,921	17.0 %	(4.6)%
淨利潤率	19.5 %	19.1 %	21.1 %	0.4	(1.6)
以下各方應佔利潤：					
母公司擁有人	48,972	41,502	48,300	18.0 %	1.4 %
非控股權益	(411)	-	2,621	-	(115.7)%
持有人應佔每股盈利					
基本	0.042	0.040	0.046	5.0 %	(8.7)%
攤薄	0.042	0.040	0.046	5.0 %	(8.7)%
付運晶圓(仟片)	531	501	530	6.0 %	0.2 %
產能利用率 ¹	96.7 %	96.8 %	101.5 %	(0.1)	(4.8)
淨資產收益率 ²	9.6 %	10.0 %	11.2 %	(0.4)	(1.6)

二零一八年第四季度

- 銷售收入再創新高，達 2.491 億美元，同比增長 14.8%，環比增長 3.3%。
- 銷售成本 1.645 億美元，同比上升 14.4%，主要由於晶圓銷售量上升及折舊成本增加；環比上升 3.3%，主要由於計提年終獎金。
- 毛利率 34.0%，同比上升 0.3 個百分點，主要得益於部分產品的售價上升及產品組合優化；環比持平。
- 經營開支 3,880 萬美元，同比上升 5.6%，主要由於人工費用上升；環比上升 22.1%，主要由於計提年終獎金。
- 其他收入淨額 1,160 萬美元，同比下降 4.8%，主要由於(i)分佔一家聯營公司溢利及獲得的補助減少，(ii)匯兌損失上升，部分被以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產取得公允價值變動收益及利息收入增加所抵消；環比下降 18.9%，主要由於本季度確認匯兌損失，上季度為匯兌收益，部分被分佔一家聯營公司溢利及利息收入增加所抵消。
- 所得稅開支 880 萬美元，同比上升 25.4%，主要由於應稅利潤增加，環比降低 34.9%，主要由於納稅扣除項的年終調整。
- 期內溢利 4,860 萬美元，同比上升 17.0%，環比下降 4.6%。
- 淨利潤率 19.5%，同比上升 0.4 個百分點，環比下降 1.6 個百分點。
- 基本每股盈利 0.042 美元，同比上升 0.002 美元，環比下降 0.004 美元。
- 淨資產收益率（年化）9.6%。

¹產能利用率按平均月產量除以總估計月產能計算。

²母公司擁有人應佔利潤 / 加權平均母公司擁有人應佔淨資產。

經營業績概要
(以千美元計，每股盈利和營運數據除外)

	二零一八年 (未經審核)	二零一七年 (已審核)	同比
銷售收入	930,268	808,148	15.1 %
銷售成本	(619,114)	(540,971)	14.4 %
毛利	311,154	267,177	16.5 %
毛利率	33.4 %	33.1 %	0.3
經營開支	(130,094)	(115,905)	12.2 %
其他收入淨額	39,995	21,215	88.5 %
稅前溢利	221,055	172,487	28.2 %
所得稅開支	(35,447)	(27,225)	30.2 %
年內溢利	185,608	145,262	27.8 %
淨利潤率	20.0 %	18.0 %	2.0
以下各方應佔利潤：			
母公司擁有人	183,158	145,262	26.1 %
非控股權益	2,450	-	-
持有人應佔每股盈利			
基本	0.171	0.140	22.1 %
攤薄	0.169	0.139	21.6 %
付運晶圓(仟片)	2,016	1,869	7.9 %
產能利用率 ³	99.2 %	98.1 %	1.1
淨資產收益率 ⁴	10.2 %	9.1 %	1.1

二零一八年度

- 銷售收入創歷史新高，達 9.303 億美元，較上年度大幅增長 15.1%。
- 銷售成本 6.191 億美元，較上年度上升 14.4%，主要由於晶圓銷售量上升、折舊成本及人員成本增加。
- 毛利率 33.4%，較上年度上升 0.3 個百分點，主要得益於產能利用率持續維持在高水平，及平均售價提升，部分被折舊成本和人員成本增加所抵消。
- 經營開支 1.301 億美元，較上年度上升 12.2%，主要由於人工費用、專業服務費及設備減值準備增加。
- 其他收入淨額 4,000 萬美元，較上年度上升 88.5%，主要得益於(i)以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產取得公允價值變動收益及(ii)利息收入增加，部分被匯兌損失上升所抵消。
- 所得稅開支 3,540 萬美元，較上年度上升 30.2%，主要由於應稅利潤增加。
- 年內溢利 1.856 億美元，較上年度上升 27.8%。
- 淨利潤率 20.0%，較上年度上升 2.0 個百分點。
- 基本每股盈利 0.171 美元，較上年度上升 0.031 美元。
- 淨資產收益率 10.2%，較上年度提升 1.1 個百分點。

³產能利用率按平均月產量除以總估計月產能計算。

⁴母公司擁有人應佔利潤 / 加權平均母公司擁有人應佔淨資產。

銷售收入分析

按類別劃分的 銷售收入	二零一八年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零一八年 第四季度 % (未經審核)	二零一七年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零一七年 第四季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
晶圓	244,073	98.0 %	212,552	98.0 %	31,521	14.8 %
其他	5,013	2.0 %	4,364	2.0 %	649	14.9 %
銷售收入總額	249,086	100.0 %	216,916	100.0 %	32,170	14.8 %

- 本季度 98.0% 的銷售收入來源於半導體晶圓的直接銷售。

銷售收入分析

按地域劃分的 銷售收入	二零一八年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零一八年 第四季度 % (未經審核)	二零一七年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零一七年 第四季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
中國 ⁵	136,324	54.6 %	122,410	56.3 %	13,914	11.4 %
美國	41,267	16.6 %	41,133	19.0 %	134	0.3 %
亞洲 ⁶	34,339	13.8 %	22,246	10.3 %	12,093	54.4 %
歐洲	19,078	7.7 %	15,581	7.2 %	3,497	22.4 %
日本 ⁷	18,078	7.3 %	15,546	7.2 %	2,532	16.3 %
銷售收入總額	249,086	100.0 %	216,916	100.0 %	32,170	14.8 %

- 本季度來自中國的銷售收入 1.363 億美元，占銷售收入總額的 54.6%，同比增長 11.4%，主要得益於通用 MOSFET 和 MCU 產品的需求增加。
- 本季度來自於亞洲的銷售收入 3,430 萬美元，同比增長 54.4%，主要得益於 MCU 和通用 MOSFET 產品的需求增加。
- 本季度來自歐洲的銷售收入 1,910 萬美元，同比增長 22.4%，主要得益於銀行卡芯片及通用 MOSFET 產品的需求增加。
- 本季度來自日本的銷售收入 1,810 萬美元，同比增長 16.3%，主要得益於邏輯和超級結產品的需求增加，部分被閃存和 MCU 產品的需求減少所抵消。

⁵包括香港。

⁶不包括中國及日本。

⁷包括於 2013 年由一家總部位於美國的公司所收購的一家主要日本客戶。

銷售收入分析

按技術平臺劃分的 銷售收入	二零一八年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零一八年 第四季度 % (未經審核)	二零一七年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零一七年 第四季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
嵌入式非易失性存儲器	99,447	39.9 %	85,940	39.6 %	13,507	15.7 %
分立器件	86,869	34.9 %	62,319	28.7 %	24,550	39.4 %
模擬與電源管理	31,405	12.6 %	40,572	18.7 %	(9,167)	(22.6)%
邏輯及射頻	27,624	11.1 %	19,200	8.9 %	8,424	43.9 %
獨立非易失性存儲器	3,581	1.4 %	8,327	3.8 %	(4,746)	(57.0)%
其他	160	0.1 %	558	0.3 %	(398)	(71.3)%
銷售收入總額	249,086	100.0 %	216,916	100.0 %	32,170	14.8 %

- 本季度嵌入式非易失性存儲器銷售收入 9,940 萬美元，同比增長 15.7%，主要得益於 MCU 和銀行卡芯片的需求增加。
- 本季度分立器件銷售收入 8,690 萬美元，同比增長 39.4%，主要得益於通用 MOSFET、超級結和 IGBT 產品的需求增加。
- 本季度模擬與電源管理銷售收入 3,140 萬美元，同比減少 22.6%，主要由於 LED 照明、模擬和其他電源管理產品的需求減少。
- 本季度邏輯及射頻銷售收入 2,760 萬美元，同比增長 43.9%，主要得益於邏輯和射頻產品的需求增加。
- 本季度獨立非易失性存儲器銷售收入 360 萬美元，同比減少 57.0%，主要由於閃存產品的需求減少。

銷售收入分析

按工藝技術節點 劃分的銷售收入	二零一八年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零一八年 第四季度 % (未經審核)	二零一七年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零一七年 第四季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
0.13 μ m 及以下	95,431	38.3 %	76,054	35.1 %	19,377	25.5 %
0.15 μ m 及 0.18 μ m	36,396	14.6 %	33,187	15.3 %	3,209	9.7 %
0.25 μ m	3,345	1.3 %	4,769	2.2 %	(1,424)	(29.9)%
0.35 μ m 及以上	113,914	45.8 %	102,906	47.4 %	11,008	10.7 %
銷售收入總額	249,086	100.0 %	216,916	100.0 %	32,170	14.8 %

- 本季度 0.13 μ m 及以下工藝技術節點的銷售收入 9,540 萬美元，同比增長 25.5%，主要得益於 MCU、銀行卡芯片及邏輯產品的需求增加。
- 本季度 0.15 μ m 及 0.18 μ m 工藝技術節點的銷售收入 3,640 萬美元，同比增長 9.7%，主要得益於 MCU 產品的需求增加。
- 本季度 0.25 μ m 工藝技術節點的銷售收入 330 萬美元，同比減少 29.9%，主要由於 MCU 產品的需求減少。
- 本季度 0.35 μ m 及以上工藝技術節點的銷售收入 1.139 億美元，同比增長 10.7%，主要得益於通用 MOSFET、超級結和 IGBT 產品的需求增加，部分被 LED 照明產品需求減少所抵消。

銷售收入分析

按終端市場分佈劃分的銷售收入	二零一八年	二零一八年	二零一七年	二零一七年	同比	同比
	第四季度 仟美元 (未經審核)	第四季度 % (未經審核)	第四季度 仟美元 (未經審核)	第四季度 % (未經審核)	仟美元	%
電子消費品	153,089	61.5 %	151,242	69.7 %	1,847	1.2 %
工業及汽車	55,402	22.2 %	28,115	13.0 %	27,287	97.1 %
通訊	28,398	11.4 %	27,358	12.6 %	1,040	3.8 %
計算機	12,197	4.9 %	10,201	4.7 %	1,996	19.6 %
銷售收入總額	249,086	100.0 %	216,916	100.0 %	32,170	14.8 %

- 本季度電子消費品作為我們的第一大終端市場，貢獻銷售收入 1.531 億美元，占銷售收入總額的 61.5%，同比增長 1.2%，主要得益於通用 MOSFET 產品的需求增加。
- 本季度工業及汽車產品銷售收入 5,540 萬美元，同比增長 97.1%，得益於銀行卡芯片、MCU、通用 MOSFET、IGBT 和邏輯產品的需求增加。
- 本季度通訊產品銷售收入 2,840 萬美元，同比增長 3.8%，主要得益於邏輯產品的需求增加，部分被其他電源管理產品的需求減少所抵消。
- 本季度計算機產品銷售收入 1,220 萬美元，同比增長 19.6%，主要得益於通用 MOSFET 產品的需求增加。

產能⁸及產能利用率

晶圓廠(仟片晶圓每月)	二零一八年 第四季度 (未經審核)	二零一七年 第四季度 (未經審核)	二零一八年 第三季度 (未經審核)
1 號晶圓廠	65	63	65
2 號晶圓廠	59	57	59
3 號晶圓廠	50	48	48
合計	174	168	172
產能利用率	96.7%	96.8%	101.5%

- 本季度末總產能增至 174,000 片。本季度產能利用率 96.7%，同比持平，環比下降 4.8 個百分點，主要由於 2 號晶圓廠的年度維護的影響。

⁸ 期末月產能，且為比較目的，以 30 天作為計算基礎。

付運晶圓

仟片晶圓	二零一八年 第四季度 (未經審核)	二零一七年 第四季度 (未經審核)	二零一八年 第三季度 (未經審核)	同比	環比
付運晶圓	531	501	530	6.0 %	0.2 %

- 本季度付運晶圓 531,000 片，同比增加 6.0%，主要由於客戶需求的增加。

經營開支分析

以千美元計	二零一八年 第四季度 (未經審核)	二零一七年 第四季度 (未經審核)	二零一八年 第三季度 (未經審核)	同比	環比
銷售及分銷費用	2,034	2,153	2,025	(5.5)%	0.4 %
管理費用 ⁹	36,785	34,620	29,773	6.3 %	23.6 %
經營開支	38,819	36,773	31,798	5.6 %	22.1 %

- 經營開支 3,880 萬美元，同比上升 5.6%，主要由於人工費用上升；環比上升 22.1%，主要由於計提年終獎金。

其他收入淨額

以千美元計	二零一八年 第四季度 (未經審核)	二零一七年 第四季度 (未經審核)	二零一八年 第三季度 (未經審核)	同比	環比
租金收入	2,958	3,362	3,253	(12.0)%	(9.1) %
利息收入	3,356	2,042	1,356	64.3 %	147.5 %
以公允價值計量且變動計入當期損益 的金融資產之公允價值變動收益	6,630	-	7,196	-	(7.9)%
匯兌(損失)/收益	(5,394)	(2,992)	1,086	80.3 %	(596.7)%
分佔一家聯營公司溢利	3,830	8,515	453	(55.0)%	745.5 %
財務費用	(431)	(572)	(487)	(24.7)%	(11.5)%
政府補貼	151	2,519	979	(94.0)%	(84.6)%
其他	520	(674)	484	(177.2)%	7.4 %
其他收入淨額	11,620	12,200	14,320	(4.8)%	(18.9)%

- 其他收入淨額 1,160 萬美元，同比下降 4.8%，主要由於(i)分佔一家聯營公司溢利及獲得的補助減少，(ii)匯兌損失上升，部分被以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產取得公允價值變動收益及利息收入增加所抵消；環比下降 18.9%，主要由於本季度確認匯兌損失，上季度為匯兌收益，部分被分佔一家聯營公司溢利及利息收入增加所抵消。

⁹管理費用包括確認為研發開支抵減項目的政府補助。

現金流量分析

以千美元計	二零一八年 第四季度 (未經審核)	二零一七年 第四季度 (未經審核)	二零一八年 第三季度 (未經審核)	同比	環比
經營活動所得現金流量淨額	91,939	88,282	72,969	4.1 %	26.0 %
投資活動所得/(用)現金流量淨額	50,342	38,653	(600,214)	30.2 %	(108.4)%
融資活動所得現金流量淨額	341,703	208	140	164180.3 %	243973.6 %
外匯匯率變動影響淨額	8,736	3,894	(25,337)	124.3 %	(134.5)%
現金及現金等價物變動影響淨額	492,720	131,037	(552,442)	276.0 %	(189.2)%

- 本季度經營活動所得現金流量淨額 9,190 萬美元，同比上升 4.1%，主要由於貿易應收款項及應收票據的回收增加。
- 投資活動所得現金流量淨額 5,030 萬美元，其中包括(i)收回以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產投資 9,850 萬美元，(ii)收到利息收入 1,280 萬美元，部分被設備投資支出 6,100 萬美元所抵消。
- 融資活動所得現金流量淨額 3.417 億美元，其中包括發行股份收到的投資款 4.005 億美元，部分被(i)償還銀行貸款本金 5,830 萬美元及(ii)支付利息 50 萬美元所抵消。

資本結構

以千美元計	於十二月三十一日 二零一八年 (未經審核)	於九月三十日 二零一八年 (未經審核)
資產總額	3,078,274	2,641,156
負債總額	373,942	396,359
所有者權益總額	2,704,332	2,244,797
資產負債率 ¹⁰	12.1%	15.0%

資本開支

以千美元計	二零一八年 第四季度 (未經審核)	二零一八年 第三季度 (未經審核)
華虹宏力	28,076	33,764
華虹無錫	32,906	28,263
合計	60,982	62,027

- 本季度資本開支 6,100 萬美元，其中 3,290 萬美元用於華虹無錫。

¹⁰ 資產負債率=負債總額/資產總額。

流動性分析

以千美元計	於十二月三十一日 二零一八年 (未經審核)	於九月三十日 二零一八年 (未經審核)
存貨	129,629	132,924
貿易應收款項及應收票據	176,797	124,932
預付款項、按金及其他應收款項	12,479	7,185
應收關聯方款項	10,800	50,228
以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產	667,033	775,311
已凍結存款及定期存款	337	340
現金及現金等價物	777,000	284,280
流動資產總額	1,774,075	1,375,200
貿易應付款項	79,470	68,632
其他應付款項、預收賬款及暫估費用	165,370	140,159
計息銀行借款	4,371	60,521
政府補助	44,406	43,722
應付關聯方款項	5,838	14,868
應付所得稅	30,114	27,015
流動負債總額	329,569	354,917
淨營運資金	1,444,506	1,020,283
速動比率	5.0x	3.5x
流動比率	5.4x	3.9x
貿易應收款項及應收票據周轉天數	57	51
存貨周轉天數	72	74

- 貿易應收款項及應收票據由上季度末的 1.249 億美元上升至本季度末的 1.768 億美元，主要由於來自於應收關聯方款項的重分類。
- 預付款項、按金及其他應收款項由上季度末的 720 萬美元上升至本季度末的 1,250 萬美元，主要由於待抵扣進項稅的增加。
- 應收關聯方款項由上季度末的 5,020 萬美元下降至本季度末的 1,080 萬美元，主要由於向貿易應收款項及應收票據所作的重分類。
- 以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產由上季度末的 7.753 億美元下降至本季度末的 6.670 億美元，主要由於贖回銀行理財產品。
- 貿易應付款項由上季度末的 6,860 萬美元上升至本季度末的 7,950 萬美元，主要由於來自於應付關聯方款項的重分類。
- 其他應付款項、預收賬款及暫估費用由上季度末的 1.402 億美元上升至本季度末的 1.654 億美元，主要由於應付資本開支增加。
- 計息銀行借款由上季度末的 6,050 萬美元下降至本季度末的 440 萬美元，主要由於償還銀行貸款。
- 應付關聯方款項由上季度末的 1,490 萬美元下降至本季度末的 580 萬美元，主要由於向貿易應付款項所作的重分類，以及確認了本季度的關聯方房屋租金。
- 應付所得稅由上季度末的 2,700 萬美元上升至本季度末的 3,010 萬美元，主要由於計提本季度所得稅開支。
- 本季度末淨營運資金 14.445 億美元，流動比率 5.4。
- 本季度貿易應收款項及應收票據周轉天數 57 天。
- 本季度存貨周轉天數為 72 天。

上述公佈詳情請參閱華虹半導體網站 www.huahonggrace.com。

華虹半導體有限公司
簡明損益表(以千美元計,每股盈利和股數除外)

	截至以下日期止三個月		
	於十二月三十一日 二零一八年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零一七年 (未經審核)	於九月三十日 二零一八年 (未經審核)
銷售收入	249,086	216,916	241,222
銷售成本	(164,508)	(143,809)	(159,276)
毛利	84,578	73,107	81,946
其他收入及收益	13,282	7,160	14,354
投資物業的公平值收益	247	89	-
銷售及分銷費用	(2,034)	(2,153)	(2,025)
管理費用	(36,785)	(34,620)	(29,773)
其他費用	(5,308)	(2,992)	-
財務費用	(431)	(572)	(487)
分佔一家聯營公司溢利	3,830	8,515	453
稅前溢利	57,379	48,534	64,468
所得稅開支	(8,818)	(7,032)	(13,547)
期內溢利	48,561	41,502	50,921
以下各方應佔利潤:			
母公司擁有人	48,972	41,502	48,300
非控股權益	(411)	-	2,621
持有人應佔每股盈利			
基本	0.042	0.040	0.046
攤薄	0.042	0.040	0.046
用於計算持有人應佔每股基本盈利的 期內已發行普通股加權平均數	1,162,589,323	1,036,020,104	1,040,919,943
用於計算持有人應佔每股攤薄盈利的 期內已發行普通股加權平均數	1,172,799,323	1,047,910,104	1,054,748,943

華虹半導體有限公司
簡明損益表(以千美元計,每股盈利和股數除外)

	二零一八年 (未經審核)	二零一七年 (已審核)
銷售收入	930,268	808,148
銷售成本	(619,114)	(540,971)
毛利	311,154	267,177
其他收入及收益	43,613	24,394
投資物業的公平值收益	247	89
銷售及分銷費用	(7,771)	(7,232)
管理費用	(122,323)	(108,673)
其他費用	(11,106)	(10,712)
財務費用	(2,203)	(2,178)
分佔一家聯營公司溢利	9,444	9,622
稅前溢利	221,055	172,487
所得稅開支	(35,447)	(27,225)
期內溢利	185,608	145,262
以下各方應佔利潤:		
母公司擁有人	183,158	145,262
非控股權益	2,450	-
持有人應佔每股盈利		
基本	0.171	0.140
攤薄	0.169	0.139
用於計算持有人應佔每股基本盈利的 期內已發行普通股加權平均數	1,070,699,301	1,034,430,282
用於計算持有人應佔每股攤薄盈利的 期內已發行普通股加權平均數	1,082,451,301	1,043,366,282

華虹半導體有限公司
簡明綜合財務狀況表(以千美元計)

	截至		
	於十二月三十一日 二零一八年 (未經審核)	於九月三十日 二零一八年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零一七年 (已審核)
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備	773,180	751,971	733,462
投資物業	171,225	170,579	179,586
預付土地租賃款項	58,989	59,012	20,634
無形資產	9,571	5,877	7,411
於聯營公司的投資	64,005	60,015	57,577
以公允價值計量且變動計入其他綜合收益的權益工具	208,357	207,925	215,864
長期預付款項	3,762	3,466	3,266
應收關聯方款項	8,747	-	-
遞延稅項資產	6,363	7,111	7,074
非流動資產總額	1,304,199	1,265,956	1,224,874
流動資產			
存貨	129,629	132,924	115,578
貿易應收款項及應收票據	176,797	124,932	112,372
預付款項、按金及其他應收款項	12,479	7,185	10,074
應收關聯方款項	10,800	50,228	46,988
以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產	667,033	775,311	-
已凍結存款及定期存款	337	340	193,530
現金及現金等價物	777,000	284,280	374,890
流動資產總額	1,774,075	1,375,200	853,432
流動負債			
貿易應付款項	79,470	68,632	68,124
其他應付款項、預收賬款及暫估費用	165,370	140,159	129,908
計息銀行借款	4,371	60,521	60,751
政府補助	44,406	43,722	40,523
應付關聯方款項	5,838	14,868	10,885
應付所得稅	30,114	27,015	26,648
流動負債總額	329,569	354,917	336,839
流動資產淨額	1,444,506	1,020,283	516,593
總資產減流動負債	2,748,705	2,286,239	1,741,467
非流動負債			
計息銀行借款	26,227	28,346	32,139
遞延稅項負債	18,146	13,096	14,123
非流動負債總額	44,373	41,442	46,262
淨資產	2,704,332	2,244,797	1,695,205
權益和負債權益			
股本	1,960,159	1,559,054	1,554,870
儲備	205,604	147,552	140,335
本公司擁有人應佔權益	2,165,763	1,706,606	1,695,205
非控股權益	538,569	538,191	-
權益總額	2,704,332	2,244,797	1,695,205

華虹半導體有限公司
簡明綜合現金流量表(以千美元計)

	截至以下日期止三個月		
	於十二月三十一日 二零一八年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零一七年 (未經審核)	於九月三十日 二零一八年 (未經審核)
經營活動所得現金流量：			
稅前溢利	57,379	48,534	64,468
折舊及攤銷	29,816	28,217	30,429
應佔聯營公司溢利	(3,830)	(8,515)	(453)
營運資金的變動及其它	8,574	20,046	(21,475)
經營活動所得現金流量淨額	91,939	88,282	72,969
投資活動所得/(用)現金流量：			
購買物業、廠房及設備項目	(60,982)	(17,780)	(62,027)
其他投資活動所得/(用)現金流量	111,324	56,433	(538,187)
投資活動所得/(用)現金流量	50,342	38,653	(600,214)
融資活動所得現金流量：			
發行股份所得收益	400,523	2,759	627
償還銀行貸款	(58,331)	(1,990)	-
已付利息	(489)	(561)	(487)
融資活動所得現金流量	341,703	208	140
現金及現金等價物增加/(減少)淨額	483,984	127,143	(527,105)
外匯匯率變動影響淨額	8,736	3,894	(25,337)
期初現金及現金等價物	284,280	243,853	836,722
期末現金及現金等價物	777,000	374,890	284,280

華虹半導體有限公司
簡明綜合現金流量表(以千美元計)

	二零一八年 (未經審核)	二零一七年 (已審核)
經營活動所得現金流量：		
稅前溢利	221,055	172,487
折舊及攤銷	119,859	104,628
應佔聯營公司溢利	(9,444)	(9,622)
營運資金的變動及其它	(57,070)	(9,193)
經營活動所得現金流量淨額	274,400	258,300
投資活動所用現金流量：		
購買物業、廠房及設備項目	(238,584)	(135,808)
其他投資活動所用現金流量	(478,655)	(61,195)
投資活動所用現金流量	(717,239)	(197,003)
融資活動所得/(用)現金流量：		
非控股權益資本注資	565,000	-
發行股份所得收益	403,956	2,759
向股東支付股息	(41,066)	(39,693)
已凍結存款的增加	(8)	(5)
償還銀行貸款	(60,613)	(1,990)
已付利息	(2,259)	(2,167)
融資活動所得/(用)現金流量	865,010	(41,096)
現金及現金等價物增加淨額	422,171	20,201
外匯匯率變動影響淨額	(20,061)	13,434
年初現金及現金等價物	374,890	341,255
年末現金及現金等價物	777,000	374,890

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

張素心(董事長)

王煜(總裁)

非執行董事

陳劍波

杜洋

森田隆之

葉峻

獨立非執行董事

張祖同

王桂壩太平紳士

葉龍堇

承董事會命

華虹半導體有限公司

張素心

董事長兼執行董事

中國 香港

二零一九年一月三十一日